国際ホトマスクシンポジウム(Photomask Japan)へのご協力のお願い

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

さて、Photomask Japanはホトマスクジャパン (PMJ)とSPIE (The International Society for Optical Engineering)の主催、BACUS、EMLCの共催を得て、マスクに関する総合的かつ実用的な国際会議として組織されたものです。本会議は毎年4月の3日間、神奈川県横浜市 パシフィコ横浜で開催しており、2018年は4月18日から20日を予定しています。

半導体デバイスの微細化は10nm以下を視野に入れ、それを実現するためにマイクロリソグラフィの技術革新が強く求められています。その中でマスクの技術革新の必要性が特に増しています。一方で日本においてもファブライト化が進行し、マスク戦略の変革が求められつつあります。

7nmノードおよびそれ以降に対してはEUVリソグラフィー(EUVL)が有望視されており、マスクの分野においても材料・加工プロセス・欠陥検査・修正技術などで新しい技術が求められています。また光リソグラフィにおいてもマルチパターニング、コンピューテーショナルリソグラフィ、Source-Mask Optimization などを用いて解像度の限界が追求されており、それに対応したマスク関連の技術開発の加速も要請されてきています。併せて、デバイスの大容量化とコンピューテーショナルリソグラフィの高度化要請に伴い、大容量LSIデータの高速・高精度処理は、益々重要な位置付けとなってきています。EUVLマスク・光リソグラフィマスク以外に、ナノインプリント技術あるいはマルチビームリソグラフィ等の開発も継続して行われ、また近年DSA(Directed Self-Assembly)技術の研究開発が活発になっていますが、いずれの候補においてもマスクが一つの重要な要素技術に位置づけられています。

マスク技術開発には製造装置、材料、プロセス、EDA等広範囲な要素技術と事業戦略的な課題に加え、大型マスクを例に挙げるまでもなく低コスト実用プロセスに対する強い期待があります。今後、このような課題を解決し、高精度化・多機能化・多様化するマスクを半導体デバイスの要請に従ってタイムリーに低コストで提供していくために、実用的な観点から、広く関連する分野の研究・技術情報を交換していくことが必須となっています。そのために会議の性格としては実用性を重視したいと考えております。

わが国のマスク技術の水準は世界をリードする立場にあり、わが国で国際会議を開催することは国際間の技術交流、国際協調に寄与する上からも意義が大きいと考えられます。本会議はこのような観点から設立され、参加者400人以上の国際会議として計画しています。

つきましては、本会議開催の趣旨とその重要性をご賢察いただき、下記のように貴社のご援助、ご高配を賜りたくお願い申し上げます。

なお、<u>Photomask Japan 2018に対しての寄付</u>によるご援助と、<u>Photomask Japan (2018年度) 賛助会員</u>としてのご援助の2通りの方法がございます。貴社のご都合にかなった方法でご協力いただければ幸いでございます。

会議の情報やProceedings等の資料、会務の報告等は、賛助会員、寄付のいずれの場合につきましても送付させていただきます。よろしくご理解の程お願い申し上げます。

- 1. <u>**賛助会入会**</u>の場合は<u>**賛助会入会申込書</u>に、継続(前年も賛助いただいた場合)は<u>賛助会**</u> **継続申込書**にてお願い申し上げます。</u>
- 2. <u>ご寄付</u>いただく場合は寄付申込書をお送りくださいますようお願い申し上げます。
- 3. 払込方法: 下記の口座にお振り込みください。

三菱東京UFJ銀行(店番号: 422) (普) 4910525

口座名: Photomask Japan 口座名フリガナ: ホトマスクジャパン

4. 本件照会先、申込書送付先

ホトマスクジャパン事務局 (担当:宮本・佐藤・太田)

〒105-8335

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

(株) JTBコミュニケーションデザイン内

電話:03-5657-0777 FAX:03-3452-8550

E-mail:pmj@jtbcom.co.jp

5. 申込並びに払込期限

2018年4月20日(金)